

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ag-copper-teplovodiv-pasta-na-bzi-mdi-1-5-ml-p-1891.html>

AG Copper Teplovodivá pasta na bázi mědi 1,5 ml



Včetně DPH	81 Kč
Bez DPH	67 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	6 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00015868

Popis produktu

AG měď je teplovodivá pasta bez zápachu. Vyrobeno na bázi mědi, je určeno k vyplnění spojů mezi procesorem a chladičem za účelem zlepšení chlazení. **AG měděná pasta** není vhodný pro hliníkové chladiče a není elektricky vodivý. Skladujte jej na dobře větraném, chladném a suchém místě. Když se nádoby nepoužívají, měly by být těsně uzavřeny a chráněny před slunečním zářením.

Specifikace:

- **Tepelná vodivost:** ~ 3,1 W/mK.
- **Balík :** 1,5 ml

Aplikace:

- plnicí spoje procesor - chladič
- není vhodný pro hliníkové chladiče, nevede elektřinu.